

芯联集成电路制造股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行和落实“以投资者为本”的发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，公司于 2024 年 3 月 26 日公布《芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，于 2024 年 8 月 31 日公布《芯联集成电路制造股份有限公司关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司以“提质增效重回报”行动方案为指引，通过系统性部署与精准执行，在提升经营效能、加速科技创新、优化股东价值回报等关键领域取得积极成效。

2025 年，公司将继续锚定“连结资源、汇聚智慧、持续创新、鼎力支撑全球智慧型新能源革命”的愿景，秉承“创新科技 点亮地球”的使命，积极开展“提质增效重回报”专项行动。公司将通过精细化管控体系升级与战略性资源配置优化，全面提升经营能效与资产回报水平；同步强化股东权益保障机制，构建长期资本增值通道，切实转化企业成长动能；将股权激励设定与公司成长深度共建，实现管理层与股东等风险共担、价值共创，持续夯实可持续发展基石。

一、深化布局系统代工主业，构建差异化竞争力

2024 年，公司秉持“市场+技术”双轮驱动的发展战略，通过与国内外新能源和高端消费类终端客户、Tier1 等头部企业以及广大设计公司的全面和深入合作，已经成长为新能源、智能化产业核心芯片的支柱性力量。同时公司全力构建汽车、AI、消费、工控四大领域增长引擎，重点布局新能源和 AI 人工智能两大应用方向。报告期内，公司实现营业收入 650,909.08 万元，同比增加 118,460.80 万元，同比增长 22.25%；实现主营业务收入 627,608.29 万元，同比增长 27.8%；首度实现年度毛利率转正 1.03%，同比增长 7.84 个百分点；归母净利润大幅改善，同比减亏 50.87%。EBITDA（息税折旧摊销前利润）实现 214,571.36 万元，同比增长 131.86%；EBITDA 利润率 32.96%，同比增长 15.58 个百分点。

2025年，公司将立足于现有的核心芯片技术水平与特有的一站式系统代工模式，深耕芯片和模组代工领域。随着公司新平台、新应用推广及新产能投产，公司在模拟 IC、模组、SiC 及 MEMS 业务将增长显著。同时，以 AI 服务器为代表的新型电源需求的全面支撑及产品代工推动，预计公司将迈入新一轮高速增长期。叠加公司运营管理效率进一步提升、高效的供应链管理及主要生产设备逐渐出折旧期等有利因素，公司毛利率将稳步提升，净利润也将取得明显突破，争取 2026 年实现全面的、有厚度的盈利转正。继续加深与合作伙伴的战略合作，强化与核心战略供应商的合作和协同降本提效，分享新产品研发机会和价值共享，保持成本竞争优势，助力公司市场竞争力和提升公司持续发展力。

二、聚焦技术研发与成果转化效能，构建协同创新生态

2024 年，公司坚持自主研发的路线，在“市场+技术”双轮驱动的发展战略下，持续研发先进的工艺及技术，提供多样化的系统代工方案。持续保持高强度研发投入，积极推动科技创新，全力促进成果转化。

2024 年公司研发投入为 184,194.82 万元，占营业收入的 28.30%。新增申请专利 259 个，新增获得专利 118 个，其中发明专利 57 个，实用新型专利 60 个，占新增获得专利总数的 99%。

在研发成果转化方面，公司拥有多个 G0 等级的模拟 IC 车规级工艺平台，应用于车载高边开关的高边智能开关芯片制造平台，已完成客户产品验证，针对 48V 系统的智能开关工艺新平台，正在积极开发中；应用于车载 BMS AFE（即电池采样芯片）的高压 BCD SOI 的集成方案工艺平台，已获得重要车企定点；应用于节点控制器和 SBC 等应用的数模混合嵌入式控制芯片制造平台，实现系统的高集成的 SoC 解决方案。；碳化硅 MOSFET 工艺平台在 650V~1700V 全电压范围实现稳定量产，公司生产的高性能、高可靠 SiC MOSFET 产品被广泛用于工控和乘用车领域；第三代 SGT MOSFET 工艺平台实现量产，产品被用于充电桩、高端服务器电源、光伏电源等领域；建立了特高压 IGBT 专用平台，并实现智能电网 4500V 产品量产，助力打造自主可控的供应链；大尺寸 MEMS 微振镜工艺平台的激光雷达微镜进入批量生产，规模应用于工业、汽车等领域，如车载激光雷达、工业 3D 扫描等，填补多项国内技术空白；完成双面/单面塑封车载模块研发，实现高性能散热的 IGBT 和碳化硅模块量产，产品广泛应用于新能源汽车主驱逆变器

领域。

2025年，公司将继续深耕产品技术的研发和迭代，不断研发出新技术、新产品，推动公司技术的进步和产品的升级迭代；运用科学高效的研发管理体系，以模块化思维构建研发全流程，基于市场需求建立科学、标准化流程体系，实现市场需求到需求分解再到项目进度追踪的透明化管理；聚焦研发关键节点的控制，推动研发项目评估、评审与风险管理的结合，提高研发成果与研发需求的匹配度；通过研发项目流程化缩短研发周期，提高研发效率；配套动态激励机制，将项目产出时间和成果与研发人员的绩效等指标强挂钩。实现重点领域研发周期的缩短，研发资源利用率的提高，关键工艺和技术参数迭代效率的提升。

三、财务+运营双轮驱动，提升资金效能

1、布局完整产品平台，拓展客户多样性，加深合作黏性

2024年公司凭借完善的产品布局、雄厚的技术积累、多样化的工艺平台以及规模化的生产能力，针对不同领域客户的定制化、多样化需求反应快速，为客户提供一站式系统代工方案；布局了SiC产品、12英寸硅晶圆产品、模组封装产品等多条产线，打造了完整的产业生态。在SiC业务方面，公司积极开发了更具成本竞争力的代工方案，持续拓展车载领域的终端客户和Tier1客户，持续导入终端客户，逐步提升市场份额。

2、提升财务关键指标，强化资金效率

2024年公司基于成熟且高效的供应链体系，对库存需求进行精准预测并动态调整库存；通过供应链共建减少冗余，加速库存周转效率。对应收账款周转率，建立客户信用评级体系，推广电子化对账管理；同时利用数字化工具实时监控周转指标，通过业财联动提升资金循环效率，增强资金流动效率。

3、盘活资金效能，聚力主业增长

2024年，公司通过资金归集、结构性存款等方式提高闲置资金收益；优化财务性投资结构，定期评估投资组合效益；同时通过产业链协同与数字化升级提升资金效能。建立动态监控机制，确保资金高效配置于公司核心业务，实现长期价值增长。

报告期内，公司于2024年10月25日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 20 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款、收益权凭证等）。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金的使用效率，获得一定的收益，为公司和股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

2025 年公司将紧密围绕业务战略布局，分层级深化客户合作体系，在合作深度上，聚焦核心客户需求，通过联合研发、资源共享等模式建立长期战略绑定；在合作力度上，强化需求与资源精准匹配，推动订单转化与价值共创；在合作广度上，横向延伸至客户关联业务场景，纵向打通产业链上下游生态；同时搭建数字化客户协同平台，构建互信共赢的战略伙伴关系网络，持续提升客户黏性与业务韧性。构建全链条精益管理体系提高资金效率，强化预算管控，动态匹配资金供需节奏，聚焦资产端深度挖潜，优先支持主业及战略新兴领域，深化产融协同，依托产业链金融工具提升上下游资金效能，兼顾短期收益与长期布局。

四、强化治理体系，驱动发展质效升级

2024 年公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

报告期内，公司根据相应法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，修订并公开披露了《独立董事工作制度》，并经相关会议审议通过。根据独立董事在公司治理中的法定地位和职责界限，各独立董事认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事在公司募集资金存放与使用、限制性股票激励计划、以集中竞价方式回购公司股份方案、并购重组项目、第二届董事会独立董事候选人资格等事项发表了独立意见或审查意见。

2024 年公司召开了 4 次股东大会共审议通过了 31 项议案；召开了 12 次董事会共审议通过了 96 项议案；召开了 12 次监事会共审议通过了 58 项议案。董事会审计委员会召开了 10 次会议及 2 次年报事项沟通会议，董事会战略与可持续发展委员会会议召开了 3 次，薪酬与考核委员会会议召开了 6 次。以上会议均

有效发挥董事会、监事会、董事会专门委员会及独立董事的作用，提高了董事会的治理能力。

同时，多次组织董监高进行相关培训，如董事会秘书后续培训、独立董事履职平台学习等；多次组织董事会办公室工作人员参加证券市场法律法规相关培训，如参加上交所上市公司公司债券、资产证券化业务培训；上市公司高质量发展系列培训-并购重组专题；多次组织董事会办公室工作人员参加专业知识培训：如组织参加上市公司董办人员专题学习班、上市公司 2023 年度信息披露与编制操作培训、上市公司董办人员信息披露实务培训等。

2025 年公司将立足企业运营现状，分层构建内控制度框架，以合规为底线，聚焦核心业务场景，创新设计控制节点；搭建“三线三层”权责体系（业务部门执行线、职能部门监督线、审计部门评价线；决策层、管理层、操作层），通过权责清单化、流程穿透式分解实现职责精准锚定；依托数字化流程引擎实现审批流、数据流、风险预警的闭环管控，同步嵌入业财融合视角下的绩效考核；强化制度运行后评估机制，结合内外部审计结果与业务反馈滚动优化，确保内控体系兼具适配性与长效性。

五、提升信息披露质效，筑牢股东权益保障根基

2024 年公司多次举办定期报告业绩说明会，认真、详实向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答，提高业绩信息的透明度和可理解性；不定期组织投资者调研活动，邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流，回答投资者关心的问题，增进双方的沟通和了解；利用互联网平台进行公开的业绩说明和互动交流，为更多投资者提供参与的机会。同时，公司设立热线和电子邮件，用于接收投资者意见和反馈，及时回应投资者的问题和反馈意见，认真对待各种咨询，建立了良好的沟通互动机制。

2025 年公司将系统性升级投资者关系管理战略，构建“定期报告业绩说明会+主题化接待日+机构调研”的常态化沟通矩阵。其中，结合定期报告业绩说明会动态释放核心经营数据；定向组织专题投资者接待日等，深度解读公司技术、战略路径等专题；开放产业链调研通道，联合机构开展前瞻性价值评估，通过可视化报告与问答实录强化双向价值传导。确保投资者关切及时响应，以透明化互动筑牢资本信任纽带。

六、促进资本配置与长期市值增长的良性互动

2024年，基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，促进公司稳定、健康、可持续发展，报告期内，公司积极落实董事长关于回购股份的提议，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份约1亿股，成交总金额约4亿元。

同时，为了推动公司产业整合，集中优势资源重点支持碳化硅等新兴业务发展，对硅基业务进一步管控整合，发挥协同和规模效应，强化公司的核心竞争力。报告期内，公司发布发行股份及支付现金购买资产预案，拟实现对子公司100%控股，进一步提升技术能力和产品线向更高端、高附加值的产品不断推进。

2025年，公司将根据市场情况，在必要的情况下，适时采取相关措施，以提振市场信心，维护股价稳定。在达到分红条件后，结合公司未分配利润情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定相应的分红方案，以实质回报投资者。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025年4月25日